

半导体材料智能制造微专业

2026 年招生简章

一、微专业介绍

本微专业面向长三角地区半导体材料、电子封装材料、电子元器件及相关制造产业发展需求，服务区域新材料与集成电路产业链，培养具有半导体材料基础知识、器件制造与封装工艺认知、材料分析检测能力和生产现场实践能力的高素质技术技能人才。

本微专业突出“材料基础+工艺认知+检测分析+产线实训”的培养主线，强调学生对半导体材料与器件领域的职业认知、岗位适应和技术应用能力提升，为学生拓展就业方向、增强复合竞争力提供支撑

二、培养目标

本微专业培养德智体美劳全面发展，具有良好的职业道德、人文素养、质量意识、安全意识和团队协作精神，掌握半导体材料与器件的基本知识，熟悉半导体衬底材料加工、先进封装与测试、电子新材料分析及洁净生产管理等基本方法，具备材料制备、工艺操作、质量检测、数据分析和生产现场管理等能力，能够在半导体材料、电子封装、电子器件制造及相关领域从事生产、检测、工艺辅助和技术服务等工作的高素质技术技能人才。

三、课程设置

1. 《半导体概论与行业标准》，2 学分，32 学时；
2. 《半导体衬底材料加工工艺》，2 学分，32 学时；

3. 《先进封装与测试技术》，2 学分，32 学时；

4. 《电子新材料分析技术》，2 学分，32 学时。

四、招生面向：面向全校全日制在籍学生，2025 级、2024 级。

五、招生计划：30 人。

六、咨询联系人：化工与新材料学院肖老师。

七、咨询电话：肖老师 13813512073。

八、咨询地点：合一楼 A409 室。

九、报名截止时间：2026 年 5 月 15 日。

十、报名方式：

1.网络报名方式：请扫描一下二维码：



2.现场报名：在咨询地点现场报名。

3.报名完成后，请将《常州工程职业技术学院学生修读微专业申请表》（见附件）提交至咨询地点。

十一、学习费用：微专业共 8 学分，按 60 元 / 学分收费，共 480 元。

十二、其他说明

1. 教学采用线上线下进行，线下时间主要安排在晚自习；练习时间周一至周五正常开放；
2. 拟组班不单独编排学号；
3. 课程成绩不合格不补考不重修，不影响评优、毕业，学分可兑换；
4. 课程成绩全部合格颁发微专业证书。

附件：常州工程职业技术学院学生修读微专业申请表